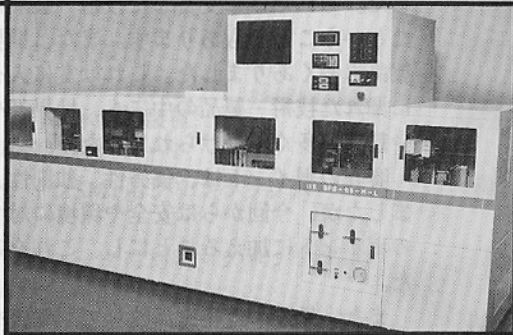


静かなソフトプレスを軸とした ICの後工程一貫製造装置



入賞 (株) 石井工作研究所

ICの後行程ラインでリードフレームの加工を行う場合、プレス工程を必要とする。プレスは振動や密閉室内での「騒音暴露基準」を越える音が発生するため、別の場所で行うしかなかった。そこで不可能だった静かなソフトプレスを開発、ICのリードフレームにモールドしたあとの半製品の供給、捺（なつ）印面洗浄、捺印、瞬間乾燥、タイバー切断、リード切断、リード曲げ、性能テスト、不良品排除、製品収納の一貫製造装置を開発した。ソフトプレスは世界初で、騒音基準に触れない性能を有し、切削時の塵（ちり）問題も解消、同室内一貫ラインを可能とした。